

特点

1. 中心放大门极结构
2. 平板型陶瓷管壳封装
3. 低通态和开关损耗

典型应用

- | | | |
|------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. 大功率变流器 | $I_{F(AV)}$ | 200A |
| 2. 焊接设备 | V_{RRM} | 2000V |
| 3. 电机控制和驱动 | I_{FSM} | 5.6KA |
| | I^2t | 160 10 ³ A ² S |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			T _J (°C)	最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, T _{hs} =55°C	150			944	A
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz 双面散热, T _{hs} =120°C	150			200	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM} = V_{RRM} + 100V$	150		2000		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM} = V_{RRM}$	150			40	mA
I_{FSM}	正向不重复峰值电流	10ms 底宽, 正弦半波	150			5.6	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6 V_{RRM}$	150			160	A ² ·10 ³
V_{FO}	门槛电压	$I_{TM} = 1500A$, $F = 15KN$	25			1.1	V
r_F	斜率电阻		150			0.32	mΩ
V_{FM}	正向峰值电压		150			1.8	V
I_{RM}	反向恢复电压	$I_{TM} = 600A$, tp=1000μs,	150				A
t_{rr}	反向恢复电流	di/dt=-20A/μs,					μs
Q_{rr}	恢复电荷	$V_R = 50V$					μC
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180°正弦波, 双面散热; 压紧力 15KN				0.040	°C/W
F_m	安装力					20	KN
T_{stg}	存储温度					160	°C
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

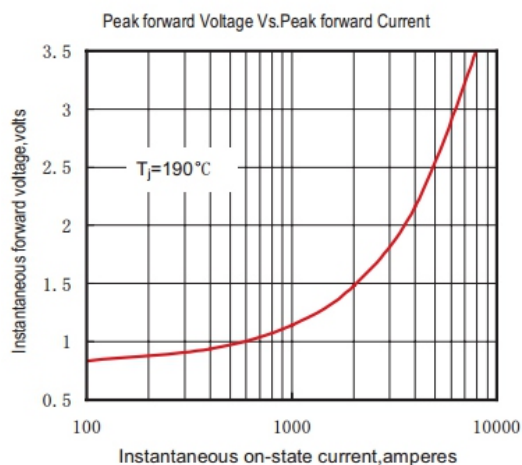


Fig.1

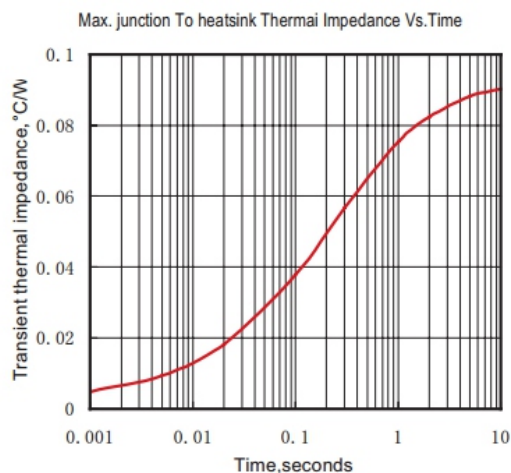


Fig.2

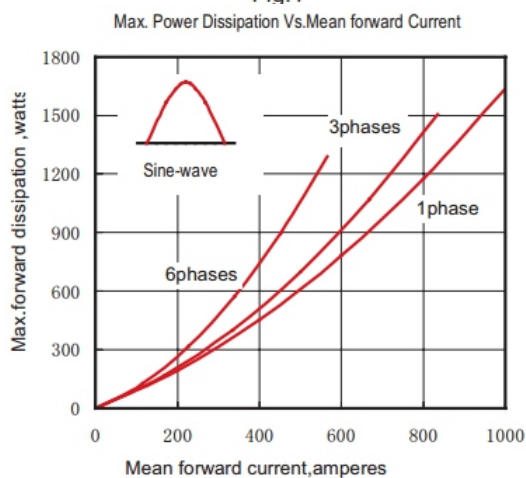


Fig.3

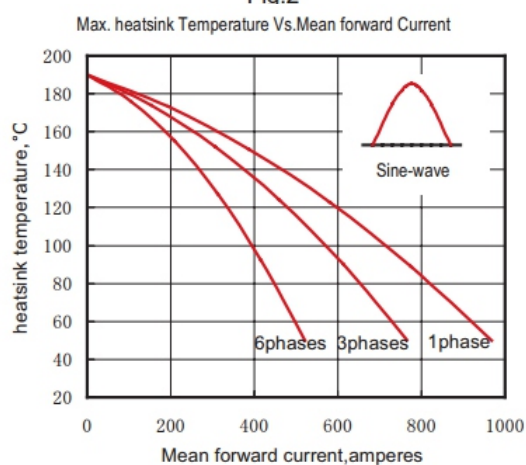


Fig.4

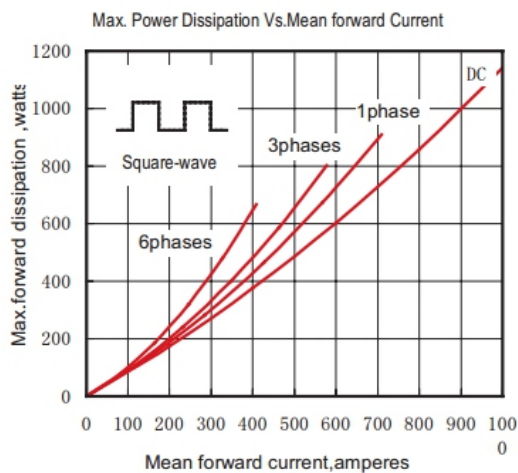


Fig.5

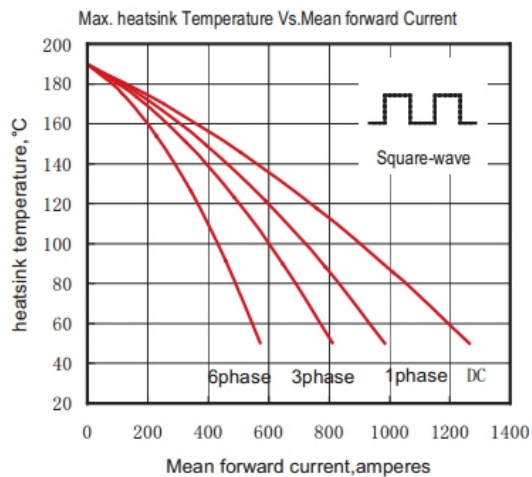


Fig.6

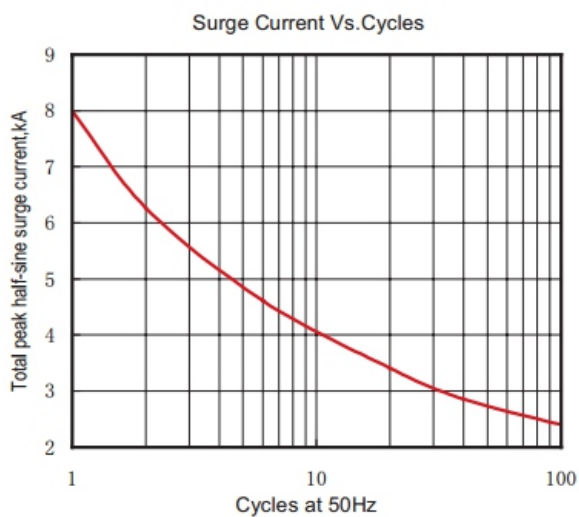


Fig.7

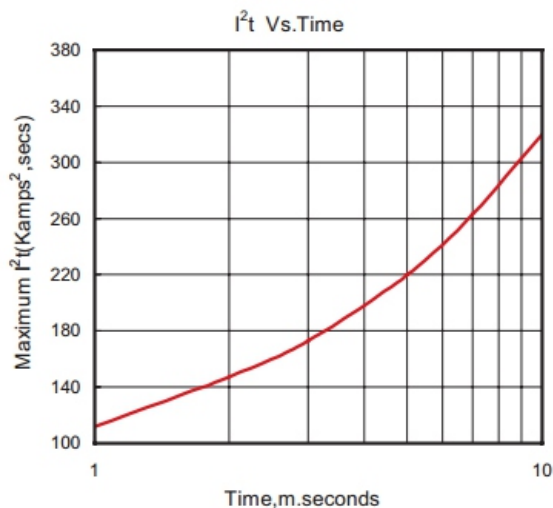


Fig.8

外形尺寸图

